Guía de filamentos Bambu

Esta guía compara las propiedades, las aplicaciones y los requisitos de impresión de los filamentos Bambu para ayudarte a elegir el material que mejor se adapte a tus necesidades.

Para consultar las especificaciones técnicas detalladas, visita la página del producto y descarga la ficha técnica (TDS) del filamento correspondiente.

Comprar filamentos

Información general	Propiedades del filamento										Preparación						Ajustes de impresión					Posprocesamiento
Filamento	Tenacidad Resistencia al impacto - XY	Resistencia Resistencia a la flexión - XY	Rigidez Módulo de flexión - XY	Adhesión entre capas Resistencia al impacto - Z	Resistencia térmica Temperatura de deflexión térmica, 0.45 MPa	Absorción de agua en saturación 25 °C, 65% HR	Dureza Shore	Rebote de bola	Resistencia Resistencia a la tracción - XY	Adhesión entre capas Resistencia al desgarro - Z	Secado antes de usar	Condiciones de secado	Compatibilidad con AMS	Diámetro/material de la boquilla	Placa compatible y temperatura de cama	Método de adhesión	¿Requiere cámara cerrada?	¿Requiere recipiente sellado con desecante?	Velocidad de impresión	Temperatura de la boquilla	Ventilador de enfriamiento de la pieza	Recocido
PLA Basic	26.6 kJ/m²	76 MPa	2750 MPa	13.8 kJ/m²	57 °C	0.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 50 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 60 - 70 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 300 mm/s	190 - 230 °C	50% - 100%	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Lite	19.0 kJ/m²	51 MPa	2240 MPa	6 kJ/m²	60 °C	0.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 50 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 60 - 70 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 250 mm/s	190 - 240 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Matte	19.2 kJ/m²	53 MPa	2360 MPa	6.6 kJ/m²	58 °C	0.40%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 50 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 60 - 70 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 300 mm/s	190 - 230 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Silk	24.5 kJ/m²	66 MPa	2370 MPa	4.6 kJ/m²	53 °C	0.52%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 250 mm/s	210 - 240 °C	Encendido	50 - 55 °C, 6 - 12 h
PLA Silk+	18.5 kJ/m²	75 MPa	2460 MPa	8.5 kJ/m²	60 °C	0.40%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 250 mm/s	210 - 240 °C	Encendido	50 - 55 °C, 6 - 12 h
PLA Metal	58.9 kJ/m²	66 MPa	2290 MPa	16.8 kJ/m²	62 °C	0.40%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 300 mm/s	190 - 230 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Sparkle	66.5 kJ/m²	63 MPa	2310 MPa	10.3 kJ/m²	55 °C	0.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 250 mm/s	190 - 230 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Galaxy	55.4 kJ/m²	58 MPa	2200 MPa	5.8 kJ/m²	55 °C	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 250 mm/s	190 - 230 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Wood	15.7 kJ/m²	55 MPa	2780 MPa	5.6 kJ/m²	60 °C	1.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 250 mm/s	190 - 240 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Marble	24.0 kJ/m²	75 MPa	2920 MPa	6.5 kJ/m²	56 °C	0.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 250 mm/s	190 - 230 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Translucent	18.5 kJ/m²	85 MPa	3000 MPa	8.5 kJ/m²	60 °C	0.34%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 50 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 60 - 70 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 150 mm/s	200 - 240 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Tough+	80.6 kJ/m²	65 MPa	2140 MPa	25.9 kJ/m²	61 °C	0.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 50 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 60 - 70 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 300 mm/s	220 - 250 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Glow	27.3 kJ/m²	76 MPa	2640 MPa	19.8 kJ/m²	55 °C	0.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 250 mm/s	190 - 230 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA Aero	28.8 kJ/m²	45 MPa	1690 MPa	3.1 kJ/m²	53 °C	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 180 mm/s	210 - 260 °C	Encendido	No se recomienda el recocido de rutina. Si se requiere: 50 - 55 °C, 6 - 12 h
PLA Pure	20.6 kJ/m²	75 MPa	2880 MPa	10.0 kJ/m²	60 °C	0.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 50 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 60 - 70 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No recomendado. El adhesivo puede afectar la seguridad de contacto de la pieza terminada. Para mejorar la adhesión, aumenta ligeramente la temperatura de la cama.	No	No	< 200 mm/s	190 - 230 °C	Encendido	50 - 60 °C, 6 - 12 h
PLA-CF	23.2 kJ/m²	89 MPa	3950 MPa	7.8 kJ/m²	55 °C	0.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6 (recomendado), 0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa de baja temperatura (45 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (50 - 55 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 200 mm/s	210 - 240 °C	Encendido	55 - 60 °C, 6 - 12 h
Support for PLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.88%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 55 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (40 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (30 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	No	< 200 mm/s	220 - 230 °C	Encendido	N/A
PETG Basic	34.2 kJ/m²	75 MPa	1950 MPa	10.5 kJ/m²	71 °C	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 65 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 80 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa PEI lisa (65 - 75 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (65 - 75 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (65 - 75 °C)	Se recomienda adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	No	No	< 200 mm/s	230 - 260 °C	0 - 60%	No se recomienda el recocido de rutina. Si se requiere: 60 - 70 °C, 4 - 8 h
PETG Matte	32.6 kJ/m²	65 MPa	1995 MPa	10.0 kJ/m²	72.3 °C	0.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 65 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 80 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (40 - 55 °C) Placa PEI lisa (55 - 65 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (55 - 65 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (40 - 45 °C)	Se recomienda adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	No	No	< 250 mm/s	230 - 260 °C	Apagado	60 - 70 °C, 6 - 12 h
PETG Translucent	37.4 kJ/m²	68 MPa	1610 MPa	7.2 kJ/m²	74 °C	0.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 65 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 75 - 85 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa PEI lisa (65 - 75 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (65 - 75 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (60 - 75 °C)	Se recomienda adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	No	No	< 220 mm/s	230 - 270 °C	0 - 60%	No se recomienda el recocido de rutina. Si se requiere: 60 - 70 °C, 4 - 8 h
PETG-CF	41.2 kJ/m²	70 MPa	2910 MPa	10.7 kJ/m²	74 °C	0.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 65 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 75 - 85 °C, 12 h	✔	0.4 / 0.6 / 0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (60 - 80 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (60 - 80 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (60 - 70 °C)	Se recomienda adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	No	Si	< 200 mm/s	240 - 270 °C	0 - 40%	65 - 70 °C, 6 - 12 h
Support for PLA/PETG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 75 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 65 - 75 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa de baja temperatura (35 - 55 °C) Placa PEI lisa (60 - 70 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (60 - 70 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 100 mm/s	190 - 220 °C	Encendido	N/A
PVA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 - 12 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa de baja temperatura (35 - 45 °C) Placa PEI lisa (35 - 45 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (35 - 45 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (35 - 45 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 200 mm/s	220 - 250 °C	Encendido	N/A
ABS	39.3 kJ/m²	62 MPa	1880 MPa	7.4 kJ/m²	87 °C	0.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 80 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa PEI lisa (90 - 100 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (90 - 100 °C)	Requiere adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	Si	No	< 300 mm/s	240 - 280 °C	0 - 80%	80 - 90 °C, 6 - 12 h
ABS-GF	14.5 kJ/m²	68 MPa	2860 MPa	5.3 kJ/m²	99 °C	0.53%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 80 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	0.4, 0.6 (recomendado), 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (90 - 100 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (90 - 100 °C)	Requiere adhesivo líquido Bambu	Si	No	< 180 mm/s	240 - 280 °C	0 - 80%	80 - 90 °C, 6 - 12 h
Support for ABS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 80 °C, 4 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 85 - 95 °C, 6 h	✔	0.4, 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (80 - 100 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (80 - 100 °C)	Requiere adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	Si	No	< 100 mm/s	240 - 270 °C	Encendido	N/A
ASA	41.0 kJ/m²	65 MPa	1920 MPa	4.9 kJ/m²	100 °C	0.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 80 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa PEI lisa (90 - 100 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (90 - 100 °C)	Requiere adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	Si	No	< 250 mm/s	240 - 280 °C	0 - 80%	80 - 90 °C, 6 - 12 h
ASA Aero	32.0 kJ/m²	58 MPa	1510 MPa	3.4 kJ/m²	85 °C	0.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	0.4 (recomendado), 0.6, 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (80 - 90 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (80 - 90 °C)	Requiere adhesivo líquido / adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 150 mm/s	240 - 280 °C	0 - 80%	80 - 90 °C, 6 - 12 h
ASA-CF	14.0 kJ/m²	72 MPa	3740 MPa	9.4 kJ/m²	110 °C	0.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Horno de convección: 80 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	0.4 / 0.6 / 0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (90 - 100 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (90 - 100 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	No	< 250 mm/s	250 - 290 °C	0 - 80%	80 - 90 °C, 6 - 12 h
PC	34.8 kJ/m²	108 MPa	2310 MPa	9.0 kJ/m²	117 °C	0.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa PEI lisa (90 - 110 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (90 - 110 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 300 mm/s	260 - 280 °C	0 - 60%	85 - 100 °C, 6 - 12 h
PC FR	55.0 kJ/m²	90 MPa	1890 MPa	8.0 kJ/m²	113 °C	0.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	Todos los diámetros/materiales	Placa PEI lisa (90 - 110 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (90 - 110 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 300 mm/s	260 - 280 °C	0 - 60%	85 - 100 °C, 6 - 12 h
TPU 75A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.70%	76 A	50%	11.5 MPa	14.0 N/mm	Obligatorio	Horno de convección: 70 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 °C, 16 h		0.4 / 0.6 / 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (30 - 35 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (30 - 35 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 200 mm/s	200 - 250 °C	Encendido	N/A
TPU 85A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	84 A	42%	20.8 MPa	8.1 N/mm	Obligatorio	Horno de convección: 70 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 °C, 16 h		0.6 / 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (30 - 35 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (30 - 35 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 80 mm/s	200 - 250 °C	50% - 100%	N/A
TPU 90A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.61%	89 A	34%	25.5 MPa	12.3 N/mm	Obligatorio	Horno de convección: 70 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 °C, 16 h		0.4 / 0.6 / 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (30 - 35 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (30 - 35 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 80 mm/s	200 - 250 °C	50% - 100%	N/A
TPU 95A HF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.08%	92 A	30%	28.9 MPa	21.1 N/mm	Obligatorio	Horno de convección: 70 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 80 - 90 °C, 12 h		0.4 / 0.6 / 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (30 - 35 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (30 - 35 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 200 mm/s	220 - 240 °C	50% - 100%	N/A
TPU for AMS	N/A	N/A	N/A	19.0 kJ/m²	N/A	1.20%	63 D	36%	16.9 MPa	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 70 °C, 8 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 80 - 90 °C, 12 h	✔	0.4 / 0.6 / 0.8 mm Boquilla de acero endurecido / acero inoxidable	Placa PEI lisa (30 - 35 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (30 - 35 °C)	No requiere adhesivo	No	Si	< 250 mm/s	220 - 240 °C	20% - 50%	N/A
PET-CF	36.0 kJ/m²	131 MPa	5320 MPa	4.5 kJ/m²	205 °C	0.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 - 12 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h		0.4 / 0.6 (recomendado)/0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (70 - 100 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (70 - 100 °C) Placa de baja temperatura de alta adherencia (60 - 80 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 100 mm/s	260 - 300 °C	0 - 40%	90 - 130 °C, 6 - 12 h
PAHT-CF	57.5 kJ/m²	125 MPa	4230 MPa	13.3 kJ/m²	194 °C	0.88%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 - 12 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	0.4 / 0.6 (recomendado)/0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (100 - 120 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (100 - 120 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 100 mm/s	260 - 300 °C	0 - 40%	90 - 130 °C, 6 - 12 h
PA6-CF	40.3 kJ/m²	151 MPa	5460 MPa	15.5 kJ/m²	186 °C	2.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 - 12 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h		0.4 / 0.6 (recomendado)/0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (100 - 120 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (100 - 120 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 100 mm/s	260 - 300 °C	0 - 40%	90 - 130 °C, 6 - 12 h
PA6-GF	27.2 kJ/m²	120 MPa	3670 MPa	4.1 kJ/m²	182 °C	2.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 80 °C, 8 - 12 h Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 90 - 100 °C, 12 h	✔	0.4 / 0.6 (recomendado)/0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (100 - 120 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (100 - 120 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 130 mm/s	260 - 290 °C	0 - 40%	90 - 130 °C, 6 - 12 h
PPS-CF	27.8 kJ/m²	142 MPa	7160 MPa	2.8 kJ/m²	264 °C	0.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 100 - 140 °C, 8 - 12 h (A mayor temperatura dentro de este intervalo, mejor resultado.) Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 110 - 120 °C, 12 h (Menos eficaz que el horno de convección.)		0.4 / 0.6 (recomendado)/0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (100 - 120 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (100 - 120 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 100 mm/s	310 - 340 °C	0 - 40%	180 - 220 °C, 6 - 12 h
PPA-CF	41.7 kJ/m²	208 MPa	9860 MPa	4.3 kJ/m²	227 °C	1.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	Obligatorio	Horno de convección: 100 - 140 °C, 8 - 12 h (A mayor temperatura dentro de este intervalo, mejor resultado.) Cama caliente de la impresora (con cubierta; voltear a mitad del secado): 110 - 120 °C, 12 h		0.4 / 0.6 (recomendado)/0.8 mm Boquilla de acero endurecido	Placa PEI lisa (100 - 120 °C) Placa PEI texturizada de doble cara (100 - 120 °C)	Requiere adhesivo en barra Bambu	Si	Si	< 100 mm/s	280 - 310 °C	0 - 40%	120 - 140 °C, 6 - 12 h